STANDARDLAGENAUFBAU HDI

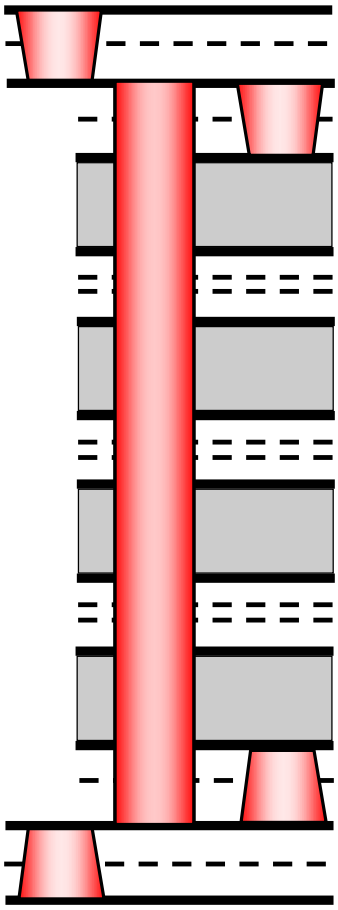
HDI12_2+8(10b)+2_1,45_17.5

12 - Lagen

Kerne: 0,15 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.:	**2 + 8(10B) + 2**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS	Folie	12 µm	1)	12	
				1 x 1080	60	
2	VSK1	Folie	9 µm		30	
				1 x 1080	66	
3	2		17.5 µm		16	
		0,150 mm			150	
4	3		17.5 µm		16	
				2 x 1080	134	
5	4		17.5 µm		16	
		0,150 mm			150	
6	5		17.5 µm		16	
				2 x 1080	134	
7	6		17.5 µm		16	
		0,150 mm			150	
8	7		17.5 µm		16	
				2 x 1080	134	
9	8		17.5 µm		16	
		0,150 mm			150	
10	9		17.5 µm		16	
				1 x 1080	66	
11	RSK1		9 µm		30	
				1 x 1080	60	
12	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12	
		1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm				
				Gesamtdicke Material:	1466	
		Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)				

MATERIALDICKE:	**1,45**	+/-	0,11	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,54	+/-	0,14	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,60	+/-	0,16	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
29.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	15+